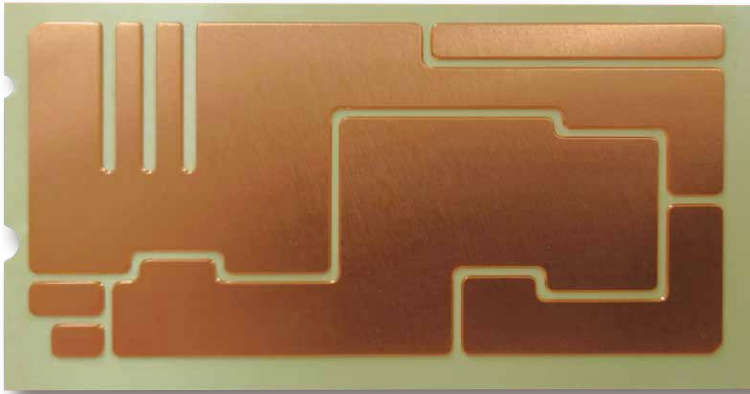


「熱伝導率 $12W / (m \cdot k)$ の高放熱性」と「高絶縁性」を有する金属基板



特長

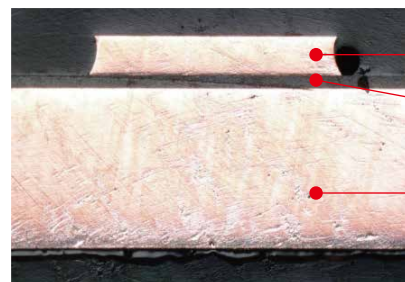
- 熱伝導率 $12W / (m \cdot k)$ 、高絶縁性
- 銅ベースによる鉛直方向への熱拡散と、回路銅による水平方向への熱拡散ができるため基板全体での熱拡散性に優れる
- 高精度／高エッチングファクタでの回路形成

基本仕様

標準構造

- 回路銅厚み： $175\mu m$ ～
- 樹脂絶縁層厚み： $125\mu m$ または $175\mu m$
- 銅ベース厚み： $2.0mm$

【基板断面】

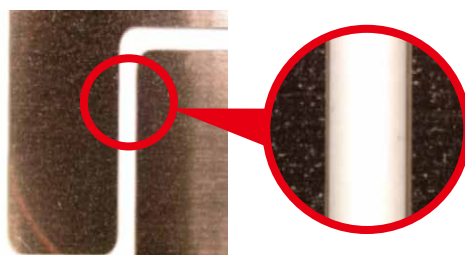


- ① 回路銅
- ② 樹脂絶縁層
- ③ 銅ベース

加工

- 回路間隔 $1.0mm$
- 基本管理公差 $+0.3 / -0.2mm$
- レジストダム形成可能

【パターン間ピッチ部と拡大図】



【レジストダム】

